

FFP D1/32H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



OMNIMATE® - 基板対基板 (B-to-B) コネクタ

小型デバイスの柔軟な開発

将来的にも有効なコンタクトシステムの採用と、製造プロセスの最適化は、効率的な産業デバイスの開発、特に Industry 4.0 の分野においてその重要性が高まっています。OMNIMATE®基板対基板コネクタは、1.27mm のピッチを特徴とし、さまざまな設計により最大の柔軟性を提供します。

- 細線仕様装置形状 - 多くの細線仕様接続の組み合わせ (メザニン、親側と子側、エクステンダーカード、ケーブルルーターボード) を組み合わせた、工業用に適した密度
- 自動化対応 - 高精度ピン平坦性と SMT 固定性を備えた自動機実装対応で開発されました
- 信頼性のある接点 - 業界に適した金表面 (PdNi-Au) により最大 500 回の結合サイクル
- 処理可能 - リフローはんだ付け対応高性能LCP 材料
- 拡張性 - 接点の重なりが大きいさまざまな高さバリエーションにより、12 - 80 極のソリューションを提供します。
- 堅固な小型化 - 傾きやオフセットなどの不利な交配条件下でも簡単に安全な接続が可能です。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, ピッチ (mm) (P): 1.27 mm, 極数: 32, トレイ (手動式アセンブリ)
注文番号	2747560000
種別	FFP D1/32H S1 B TY
GTIN (EAN)	4064675000495
数量	100 items
製品データ	IEC: / 1.9 A UL: 150 V / 1 A / AWG 30 sol - AWG 30 sol
パッケージ	トレイ (手動式アセンブリ)

FFP D1/32H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E92202

寸法と重量

深さ	5.6 mm	奥行き (インチ)	0.2205 inch
高さ	14.05 mm	高さ (インチ)	0.5531 inch
幅	28.1 mm	幅 (インチ)	1.1063 inch
正味重量	2.89 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - ボード ツープード	接続方式	絶縁変位接続 (IDC)
導体接続方法	IDC端末	ピッチ (mm) (P)	1.27 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.050 "	導体取り出し方向	90°/270°
極数	32	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	2	保護度合い	IP20
体積抵抗	<25 mΩ	プラグイン回数	500
差し込み力 / 極、最大	0.6 N	引張強度/極、最大	0.6 N

材料データ

絶縁材	LCP	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
絶縁抵抗	$\geq 10^{10} \Omega$	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 可燃性等級	V-0	接点ベース素材	銅合金
接点材質	銅合金	接触表面	Ni/Au
プラグ接点の層構造	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m PdNi} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-55 °C
動作温度、最大	125 °C		

接続に適した導体

配線接続断面 AWG、最小	AWG 30/1、30/7	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 30/1、30/7
絶縁物外径、最大	0.55 mm	絶縁物外径、最大	0.75 mm

IEC規格に準拠した公称データ

定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	1.9 A	定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	2.3 A
定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	2.5 A	沿面距離、最小	0.4 mm
クリアランス、最小	0.4 mm		

FFP D1/32H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL1977に準拠した公称データ

承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。	定格電圧 (UL 1977) (廃止)	150 V
定格電流 (UL 1977) (廃止)	1 A	AWG 導体、最小 (UL 1977)	30 sol
AWG 導体、最大 (UL 1977)	30 sol		

梱包

パッケージ	トレイ (手動式アセンブリ)	VPE 長	350.00 mm
VPE幅	340.00 mm	VPEの高さ	135.00 mm

重要なメモ

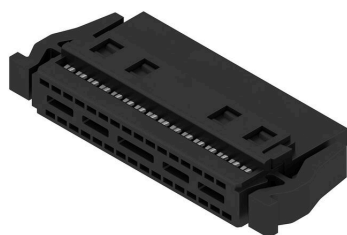
IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
-------	---

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

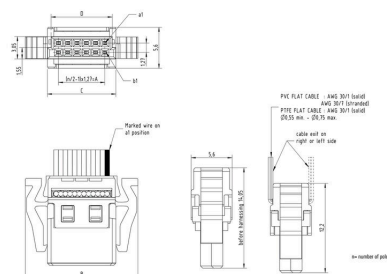
図面



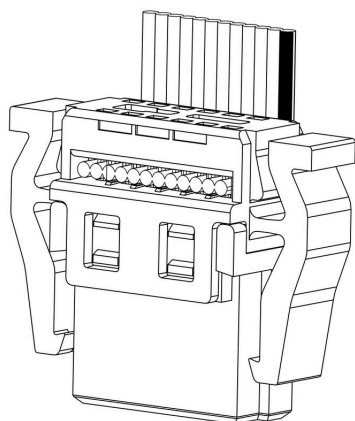
With optional strain relief

寸法図

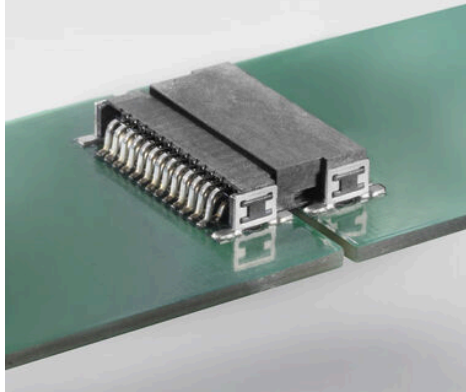
Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E
FFP D1/12H S1 B TY	2747520000	12	8,26	15,4	6,37	6,37	15
FFP D1/16H S1 B TY	2747520000	16	8,85	17,84	11,91	10,91	15
FFP D1/20H S1 B TY	2747540000	20	11,43	20,48	14,45	13,45	15
FFP D1/24H S1 B TY	2747560000	24	15,41	24,29	19,25	17,25	15
FFP D1/32H S1 B TY	2747580000	32	19,05	28,1	22,07	21,07	15
FFP D1/40H S1 B TY	2747590000	40	24,13	33,18	27,16	26,16	15
FFP D1/50H S1 B TY	2747590000	50	30,48	39,53	33,5	32,5	15
FFP D1/60H S1 B TY	2747590000	60	41,91	50,86	44,83	43,83	16,2
FFP D1/80H S1 B TY	2747590000	80	49,53	58,58	50,86	50,86	16,2



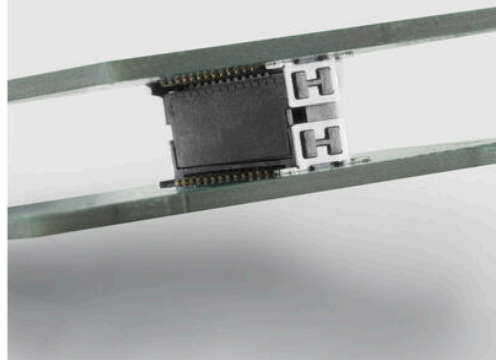
詳細図面



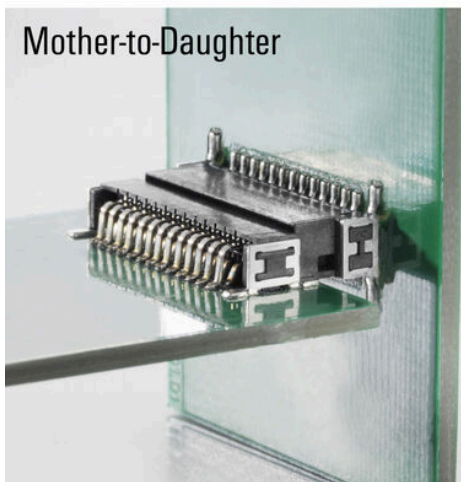
Extender-Board



Mezzanine



Mother-to-Daughter



Board-to-Wire



FFP D1/32H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

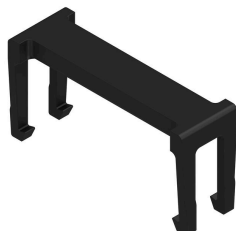
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

FC/FFP – ストレインリリーフ (アクセサリ)



OMNIMATE® - 基板対基板 (B-to-B) コネクタ

小型デバイスの柔軟な開発

将来的にも有効なコンタクトシステムの採用と、製造プロセスの最適化は、効率的な産業デバイスの開発、特に Industry 4.0 の分野においてその重要性が高まっています。OMNIMATE®基板対基板コネクタは、1.27mm のピッチを特徴とし、さまざまな設計により最大の柔軟性を提供します。

- 細線仕様装置形状 – 多くの細線仕様接続の組み合わせ (メザニン、親側と子側、エクステンダーカード、ケーブルツールボード) を組み合わせた、工業用に適した密度
- 自動化対応 - 高精度ピン平坦性と SMT 固定性を備えた自動機実装対応で開発されました
- 信頼性のある接点 - 業界に適した金表面 (PdNi-Au) により最大 500 回の結合サイクル
- 処理可能 - リフローはんだ付け対応高性能LCP 材料
- 拡張性 - 接点の重なりが大きいさまざまな高さバリエーションにより、12 – 80 極のソリューションを提供します。
- 堅固な小型化 – 傾きやオフセットなどの不利な交配条件下でも簡単に安全な接続が可能です。

一般注文データ

種別	FC/FFP ZE/32 B BX	バージョン
注文番号	2853130000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4064675475903	1.27 mm, 極数: 32, 箱
数量	100 ST	

FFP D1/32H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

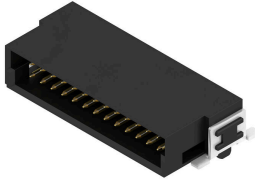
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

対応

FMH – オス型ヘッダ – 基板対基板コネクタ



OMNIMATE® - 基板対基板 (B-to-B) コネクタ

小型デバイスの柔軟な開発

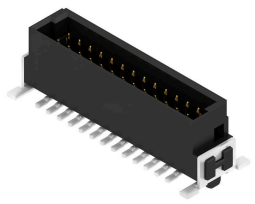
将来的にも有効なコンタクトシステムの採用と、製造プロセスの最適化は、効率的な産業デバイスの開発、特に Industry 4.0 の分野においてその重要性が高まっています。OMNIMATE®基板対基板コネクタは、1.27mm のピッチを特徴とし、さまざまな設計により最大の柔軟性を提供します。

- 細線仕様装置形状 – 多くの細線仕様接続の組み合わせ (メザニン、親側と子側、エクステンダーカード、ケーブルツールボード) を組み合わせた、工業用に適した密度
- 自動化対応 - 高精度ピン平坦性と SMT 固定性を備えた自動機実装対応で開発されました
- 信頼性のある接点 - 業界に適した金表面 (PdNi-Au) により最大 500 回の結合サイクル
- 処理可能 - リフローはんだ付け対応高性能LCP 材料
- 拡張性 - 接点の重なりが大きいさまざまな高さバリエーションにより、12 – 80 極のソリューションを提供します。
- 堅固な小型化 – 傾きやオフセットなどの不利な交配条件下でも簡単に安全な接続が可能です。

一般注文データ

種別	FMH S1/32H F1 B RL	バージョン
注文番号	2747200000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, SMDはんだ接
GTIN (EAN)	4064675001041	続, ピッチ (mm) (P): 1.27 mm, 極数: 32, 90°, Tape
数量	560 ST	

FMH1 – オス型ヘッダ – ボード間接続 (スタック高さ 1.75 mm)



OMNIMATE® - 基板対基板 (B-to-B) コネクタ

小型デバイスの柔軟な開発

将来的にも有効なコンタクトシステムの採用と、製造プロセスの最適化は、効率的な産業デバイスの開発、特に Industry 4.0 の分野においてその重要性が高まっています。OMNIMATE®基板対基板コネクタは、1.27mm のピッチを特徴とし、さまざまな設計により最大の柔軟性を提供します。

- 細線仕様装置形状 – 多くの細線仕様接続の組み合わせ (メザニン、親側と子側、エクステンダーカード、ケーブルツールボード) を組み合わせた、工業用に適した密度
- 自動化対応 - 高精度ピン平坦性と SMT 固定性を備えた自動機実装対応で開発されました
- 信頼性のある接点 - 業界に適した金表面 (PdNi-Au) により最大 500 回の結合サイクル
- 処理可能 - リフローはんだ付け対応高性能LCP 材料
- 拡張性 - 接点の重なりが大きいさまざまな高さバリエーションにより、12 – 80 極のソリューションを提供します。
- 堅固な小型化 – 傾きやオフセットなどの不利な交配条件下でも簡単に安全な接続が可能です。

FFP D1/32H S1 B TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

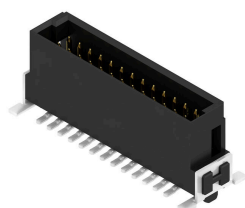
www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	FMH1 S1/32V F1 B RL	バージョン
注文番号	2747020000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, SMDはんだ接
GTIN (EAN)	4064675001492	続, ピッチ (mm) (P): 1.27 mm, 極数: 32, 180°, Tape
数量	280 ST	

FMH3 - オス型ヘッダ - 基板対基板コネクタ (スタック高さ 3.25 mm)



OMNIMATE® - 基板対基板 (B-to-B) コネクタ

小型デバイスの柔軟な開発

将来的にも有効なコンタクトシステムの採用と、製造プロセスの最適化は、効率的な産業デバイスの開発、特に Industry 4.0 の分野においてその重要性が高まっています。OMNIMATE®基板対基板コネクタは、1.27mm のピッチを特徴とし、さまざまな設計により最大の柔軟性を提供します。

- 細線仕様装置形状 - 多くの細線仕様接続の組み合わせ (メザニン、親側と子側、エクステンダーカード、ケーブルツールボード) を組み合わせた、工業用に適した密度
- 自動化対応 - 高精度ピン平坦性と SMT 固定性を備えた自動機実装対応で開発されました
- 信頼性のある接点 - 業界に適した金表面 (PdNi-Au) により最大 500 回の結合サイクル
- 処理可能 - リフローはんだ付け対応高性能LCP 材料
- 拡張性 - 接点の重なりが大きいさまざまな高さバリエーションにより、12 - 80 極のソリューションを提供します。
- 堅固な小型化 - 傾きやオフセットなどの不利な交配条件下でも簡単に安全な接続が可能です。

一般注文データ

種別	FMH3 S1/32V F1 B RL	バージョン
注文番号	2747110000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, SMDはんだ接
GTIN (EAN)	4064675001058	続, ピッチ (mm) (P): 1.27 mm, 極数: 32, 180°, Tape
数量	280 ST	